

信昌電子陶瓷股份有限公司

2026年法人說明會

(Stock code: 6173)

報告日期:2026年9月10日

投資人關係聯絡人：發言人 羅夏盈
Email：IR@pdc.com.tw
電話：03-4753355

報告內容

- 公司概述
- 財務績效
- 產品應用與主要市場展望
- 營業聚焦與機會

公司概述

信昌電陶

- 成立日期 1990年6月
- 資本額 新台幣16.09 億 (減資後)
- 員工人數 759 人
- 品牌 PDC
- 營業額 2025年 NT \$ 40.50 億 (YoY + 9%)
2026 H1 NT \$ 23.92 億 (YoY +16%)

營運據點

- 台灣 桃園廠(Powder/CR) / 楊梅廠一廠(MLCC)
楊梅二廠及六甲廠(預計2027 H2 量產)
- 中國 東莞銷售據點/物流中心

生產經歷

- MLCC/CR Since 1990 (36 years)
- Powder Since 1995 (31 years)



- 楊梅二廠:
主要生產高壓/低損耗
高溫穩定型 MLCC



- 六甲廠:
主要建置新一代自動
化高效生產陶瓷粉末
及開發次世代粉材



PSA

合併綜合損益比較

單位:台幣百萬元;每股盈餘為元

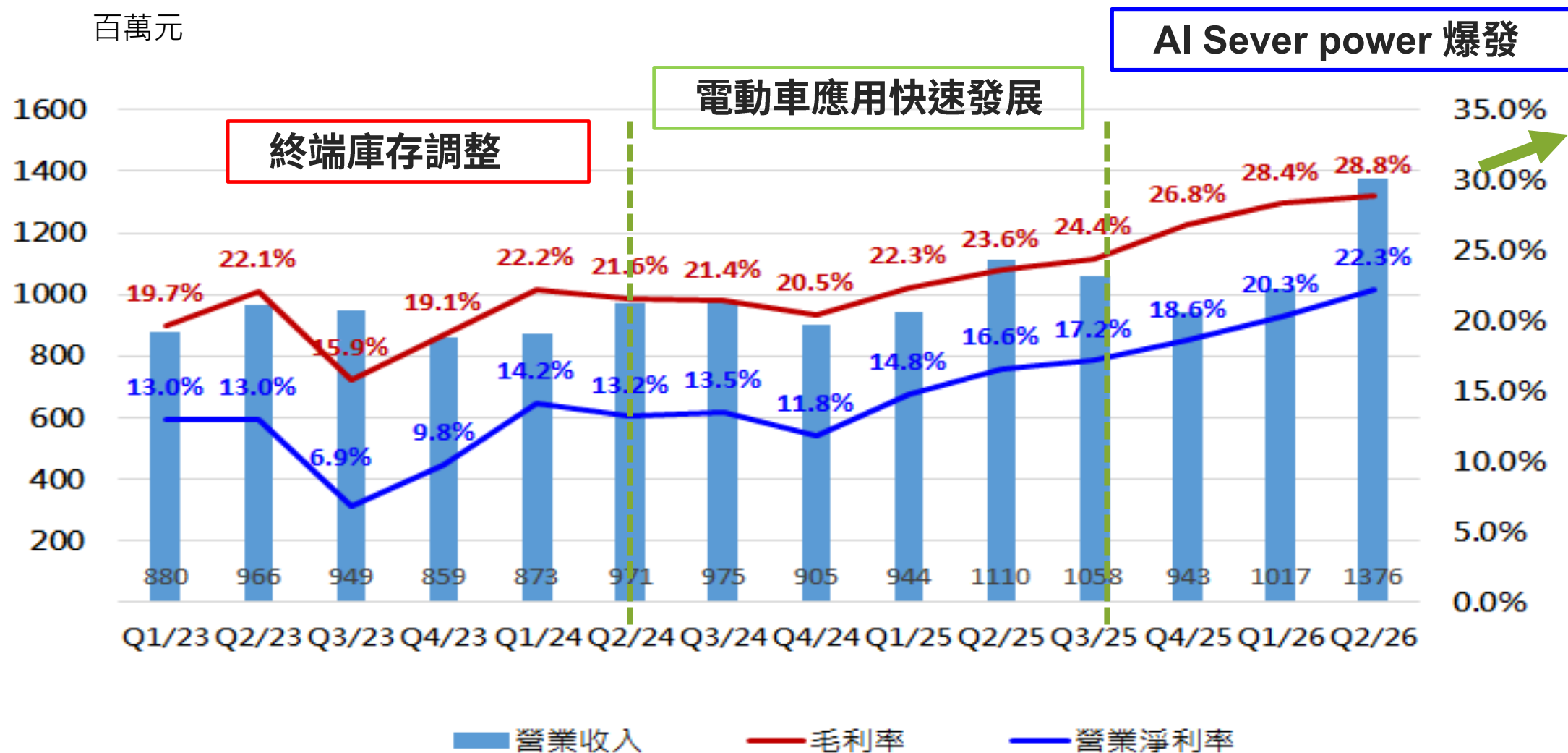
	2026 第二季	2026 第一季	QoQ	成長(%)	2025 第二季	YoY	成長(%)
營業收入	1,376	1,017	359	35%	1,110	265	24%
營業毛利	397	288	108	38%	262	135	51%
毛利率(%)	28.8%	28.4%	0.5%		23.6%	5.2%	
營業淨利	306	207	100	48%	184	122	67%
營業淨利率(%)	22.3%	20.3%	1.9%		16.6%	5.7%	
稅前淨利	384	258	126	49%	55	329	598%
歸屬本公司業主之稅後淨利	306	205	102	50%	40	267	671%
稅後淨利率(%)	22.3%	20.1%	2.1%		3.6%	18.7%	
每股盈餘(元)	1.79	1.19	0.6		0.23	1.56	

合併綜合損益比較

單位:台幣百萬元;每股盈餘為元

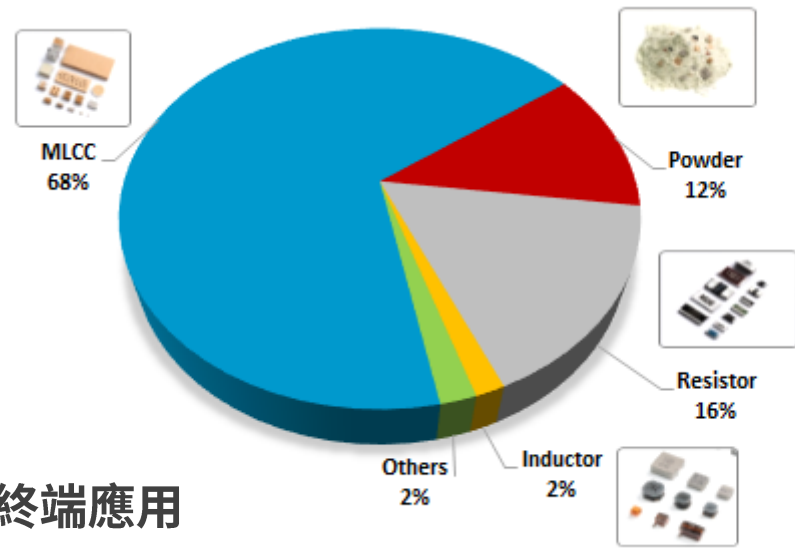
	2026 H1	2025 H2	QoQ	成長(%)	2025 H1	YoY	成長(%)
營業收入	2,392	2,001	391	20%	2,054	338	16%
營業毛利	685	511	174	34%	473	212	45%
毛利率(%)	28.6%	25.6%	3.1%		23.0%	5.6%	
營業淨利	513	357	156	44%	324	189	59%
營業淨利率(%)	21.4%	17.8%	3.6%		15.8%	5.7%	
稅前淨利	642	501	141	28%	208	434	208%
歸屬本公司業主之稅後淨利	511	397	113	29%	160	351	219%
稅後淨利率(%)	21.4%	19.9%	1.5%		7.8%	13.6%	
每股盈餘(元)	2.98	2.32	0.66		0.94	2.04	

營收/毛利率/營業淨利 趨勢



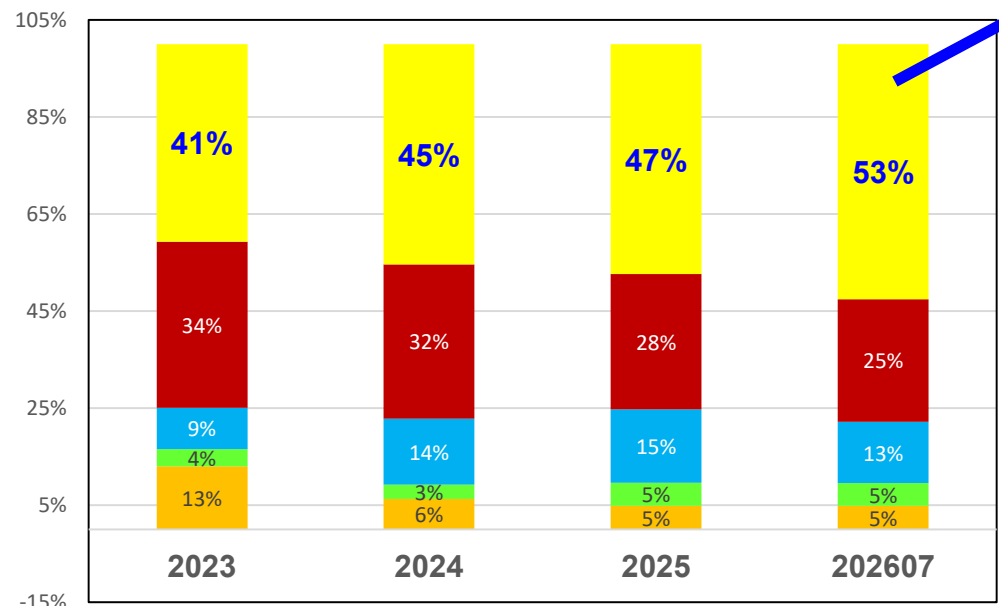
2026 H1 營收比重分析

依產品

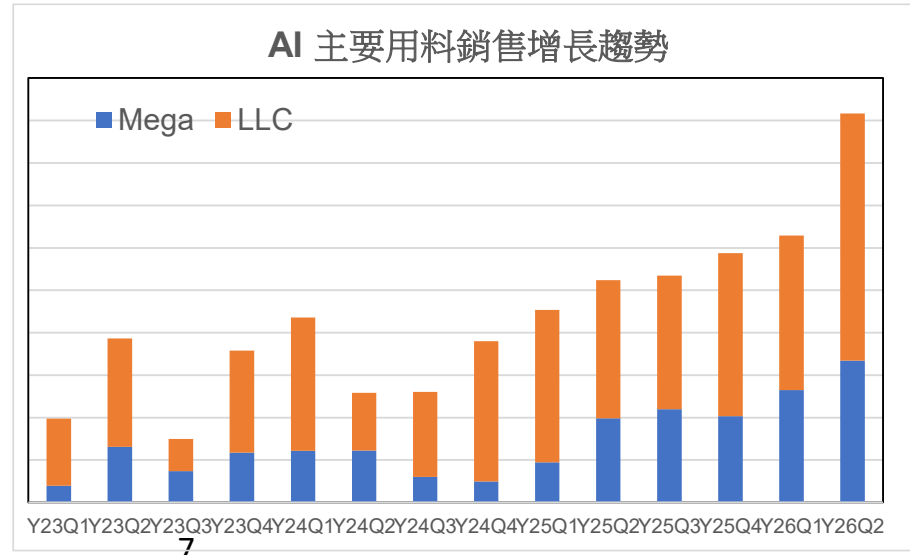
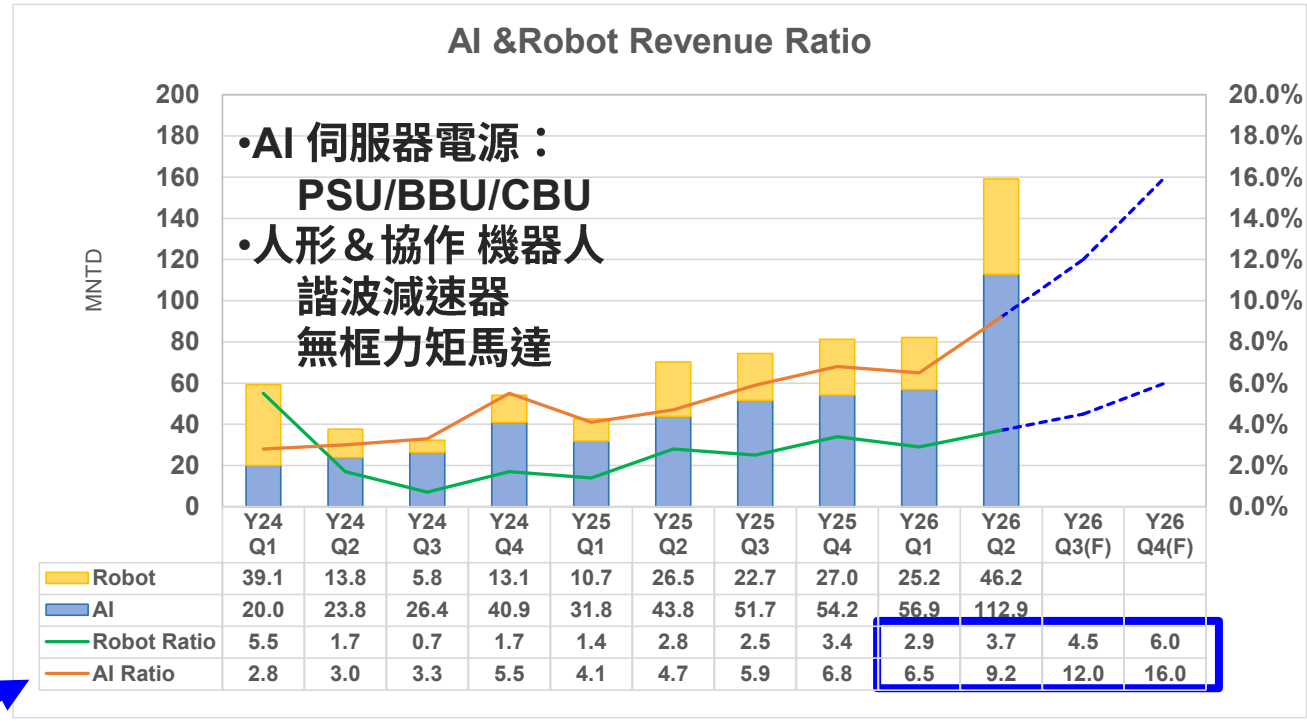


依終端應用

Industrial Networking Automotive Specialty Consumer



工業應用持續聚焦



- 高耐應力及散熱- Mega Cap
- 低損耗高壓 NPO for LLC

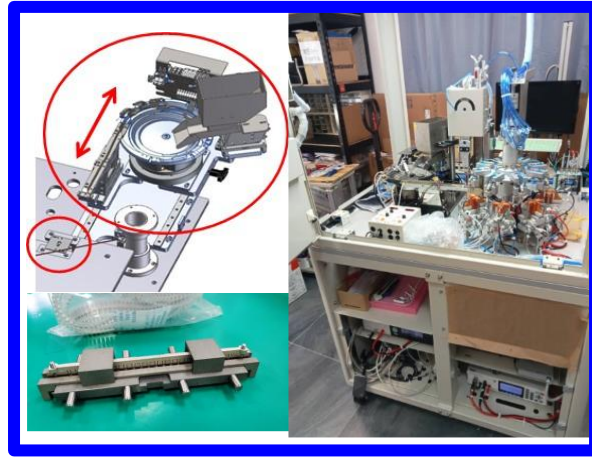
核心優勢：快速對應客戶需求 立即提供最佳方案

自製陶瓷介電材料



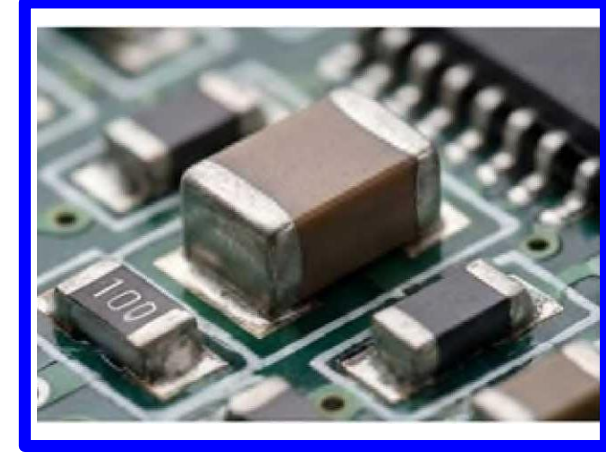
介電粉末配方及細化技術
微波通訊<CC 材料
LEO low Dk 參雜材料

自有自動化設備開發團隊



特殊品相關治模具設計
Lead frame & 合金材料客製化設計
高自動化量測檢測設備開發

專精高階大尺寸&特殊客製化被動元件



高可靠性特殊
MLCC 與貼片電阻

PDC是台灣唯一能垂直整合 MLCC陶瓷粉末、自動化設備、及生產高階大尺寸高功率之MLCC及貼片電阻的製造商，確保了品質穩定、成本控制及提供省電高效的特殊被動元件以因應AI 產業快速變革的需求。

產品規劃及應用

- 4G基站
- 伺服器
- Modem/Router/STB
- 電源供應器
- 消費電子產品

- AI伺服器
- BBU,PD3.1電源
- 電動車
- 工業機器人
- 5G基站
- 醫療、航太
- 智慧電網

- 人型機器人
- 自駕車
- AI 機櫃電源
- AI 資料中心
- 低軌衛星
- 電動車無線充

2015

營業收入:NT 2.39B
營業毛利率:18.9%
EPS: 0.74

產品主軸

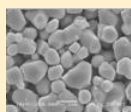
-元件:工業、網通、消費高功率
MLCC,CHIP-R,Inductor



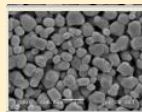
-材料:Disc,MLCC介電陶瓷粉末



Ceramic Dielectric Powders



800nm



600nm

2025

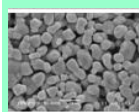
營業收入:NT 4.05B
營業毛利率:24.3%
EPS:3.26

產品主軸

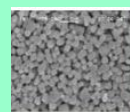
-元件:工業、網通、車用、醫療、航太用高功率高可靠度
MLCC,CHIP-R



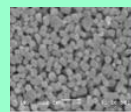
-材料:Disc,高規格MLCC,LTCC,微波介電陶瓷粉末



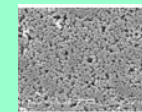
400nm



250nm



250nm



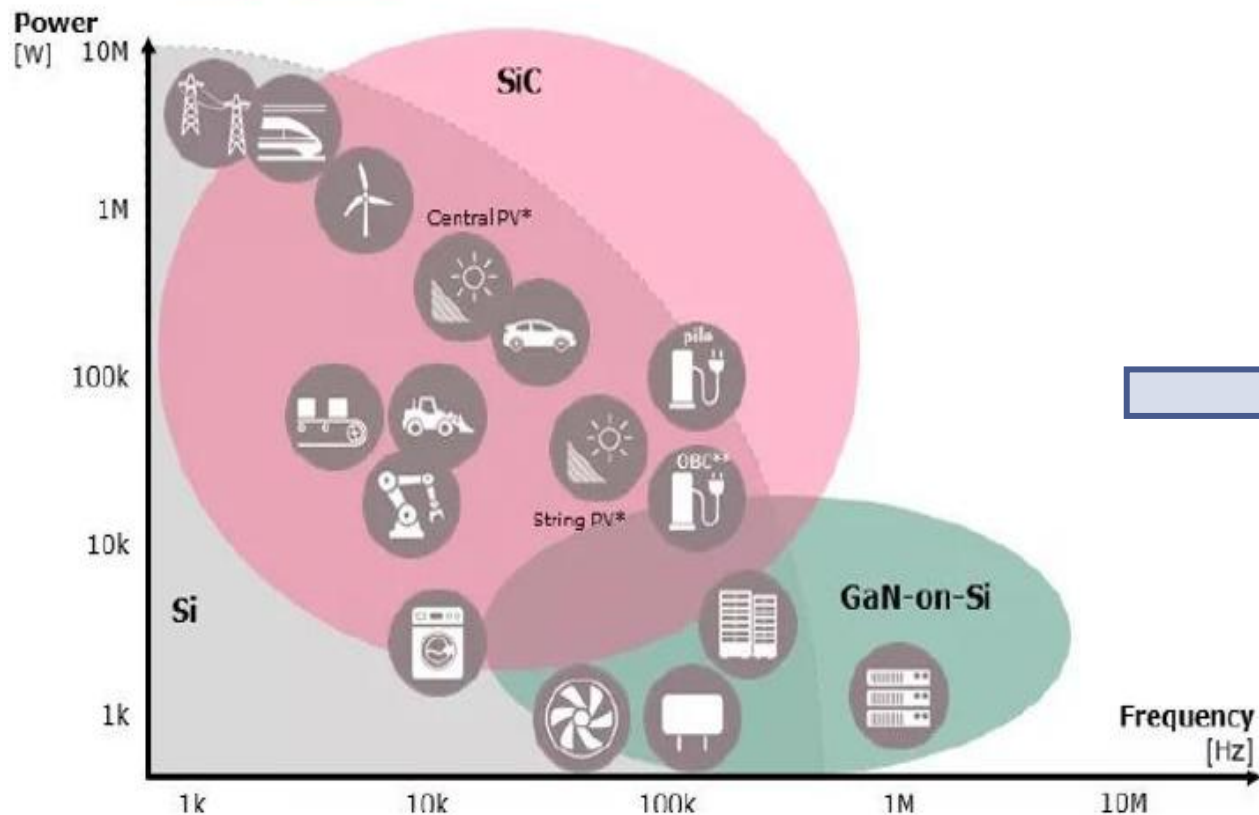
200nm

2026 H1

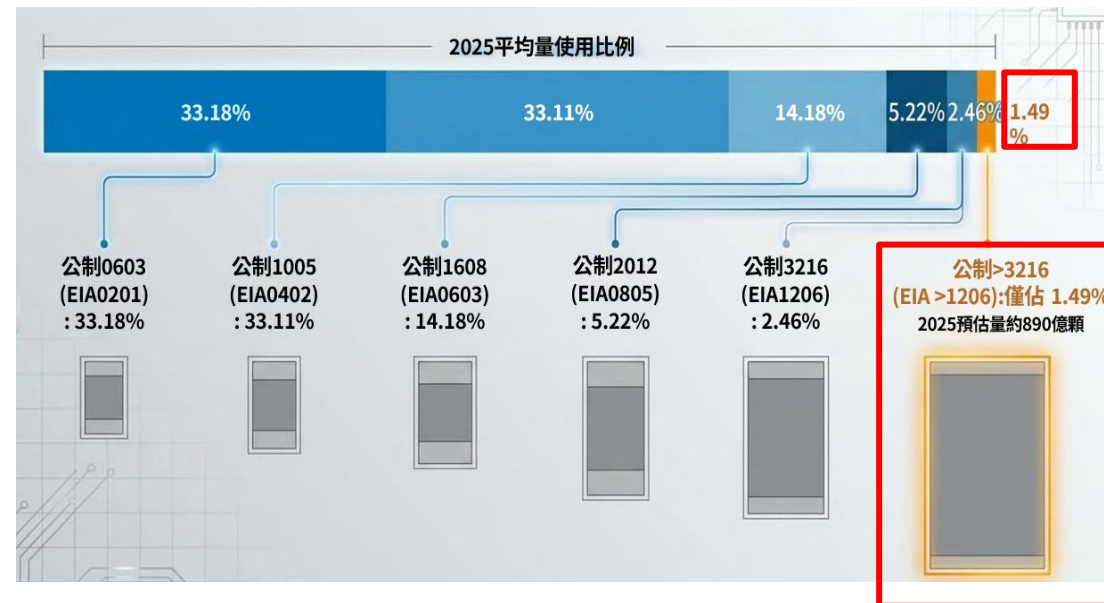
營業收入:NT2.39 B
營業毛利率:28.6%
EPS:2.98

市場應用趨勢

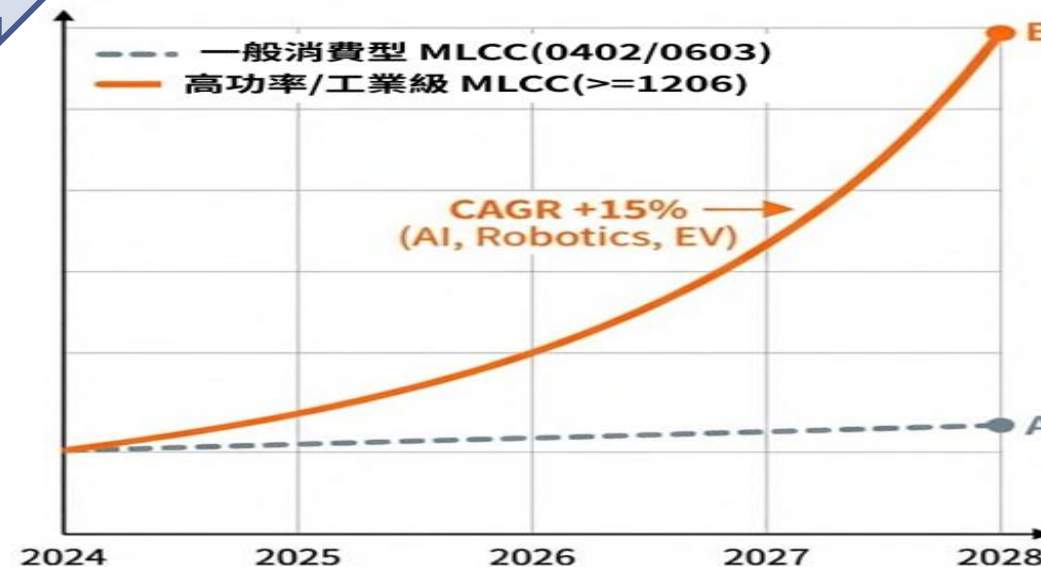
SiC、GaN比Si更適合用在高壓、高頻上



資料來源:英飛凌



市場成長趨勢預測(2024-2028)



隨著第三代半導體(GaN,SiC)的普及應用帶動大尺寸被動元件商機越趨擴大。

PSA

PDC高功率產品6大主要應用領域



AI伺服器與資料中心

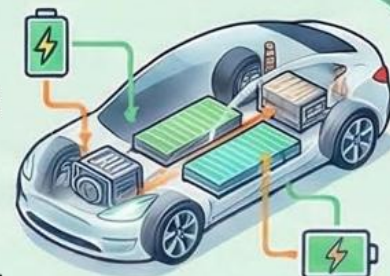
提供AI 電源機櫃所需的

- 1 中高壓MLCC.
- 2 Metal Strip, FBF
- 3 大尺寸高功率厚膜電阻

電動車電子核心

提供符合AEC-Q200車規認證的MLCC

- 1 中高壓MLCC
- 2 Metal Strip, FBF
- 3大尺寸高功率厚膜電阻



滿足5G基站的需求

- 1 中高壓MLCC.
- 2 Metal Strip, FBF
- 3大尺寸高功率厚膜電阻



工業及人形機器人

- 1中高壓MLCC.
- 2 Metal Strip, FBF
- 3大尺寸高功率厚膜電阻



低軌道衛星

- 1 中高壓MLCC.
- 2 Metal Strip, FBF
- 3大尺寸高功率厚膜電阻

應對48V電力統新趨勢

- 1 中高壓MLCC.
- 2 Metal Strip, FBF
- 3 大尺寸高功率厚膜電阻



PDC核心MLCC產品組合

Mega Cap

(堆疊型電容)

規格：
Chip Size
1206 to 2220

應用：
航太、醫療、軍用、工業
高振動及機械應力環境



LLC NPO電容

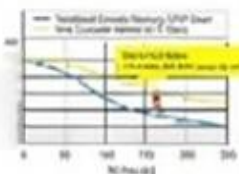
規格：1206-2220
630V~2,000V
10nF to 100nF

特色：
替代薄膜電容
應用：
12/25/48V LLC迴路



低DC BIAS電容 (X7T)

規格：
1210-2220
250V-1KV
1uF to 10uF
應用：
12/25/48V
DC/DC, SMPS



客制化電容器

Chip Size Max 13060
VV Max 10KV



應用：
醫療, 航太, 軍用, 工業

安規電容

(Safety Certified Cap)

規格：
X1/Y2, X2/Y3
1206-2220
3000V/5000V



應用：
電源EMI濾波

車規級電容

(Automotive Certified. Cap)

規格：AEC-Q200
X7R/NPO 1206-2220
50V-4KV

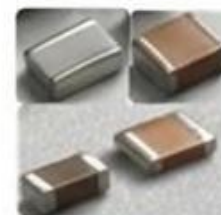
應用：
BMS, OBC,
Inverter, 48V DC



中高壓&高信賴性 MLCC

規格：
1206-2225
100V-10KV
1uF to 10uF

應用：
電源、逆變器



MEGA Cap: 高可靠性金屬端子電容與市場應用

核心產品特性與安全優勢

一般晶片電容 (Chip Cap)

傳統電容承受機械應力時缺乏緩衝，陶瓷體極易龜裂並導致短路燃燒風險。



MEGA Cap (FE Series) 金屬端子緩衝技術



特性

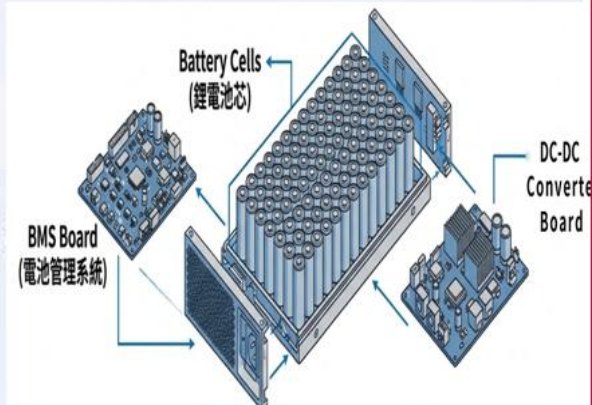
1. 高耐應力防止MLCC因應力造成的短路失效甚至電源端短路燃燒。
2. 高散熱設計,可有效降低熱積累適合應用於AI SERVER 電源機櫃及其他高功率電源設計。
3. 可減少嘯叫(MLCC 因壓電效應產生的噪音)。
4. 有效降低ESL(等效串聯電感)。
5. 有效減少設計面積。

產業應用與市場機會



1. AI SERVER 電源。
2. BBU BMS 48V DC/DC。
3. AI Mini station。

4. Data Center 冷卻系統。
5. 人形及工業機器人。
6. EV OBC。



GB300與VR200 單一機架材料成本估算比較

Source:2026.05.20 Morgan Stanley

Nvidia NVL72 單一機櫃物料成本估算比較

單一 VR200 NVL72 機櫃總成本約為 US\$7.8M

物料項目	GB300 成本 (US\$)	VR200 成本 (US\$)	差異金額 (US\$)	漲幅
GPU	\$2,520,000	\$3,960,000	+\$1,440,000	57% ▲
CPU	\$180,000	\$180,000	\$0	0%
NVLink 交換晶片	\$64,800	\$144,000	+\$79,200	122% ▲
其他網路晶片	\$261,000	\$576,000	+\$315,000	121% ▲
記憶體	\$373,939	\$2,001,600	+\$1,627,661	435% ▲
散熱	\$64,610	\$72,080	+\$7,470	12% ▲
電源供應	\$57,600	\$76,000	+\$18,400	32% ▲
PCB 板	\$35,100	\$116,730	+\$81,630	233% ▲
ABF 載板	\$11,160	\$20,340	+\$9,180	82% ▲
MLCC 被動元件	\$1,530	\$4,320	+\$2,790	182% ▲
其他項目	\$402,412	\$623,278	+\$220,866	55% ▲
機櫃組裝與其他加值	\$22,400	\$28,800	+\$6,400	29% ▲
總計	\$3,994,551	\$7,803,148	+\$3,808,597	95% ▲

漲幅最大前三名

1

記憶體

+435%

2

PCB 板

+233%

3

MLCC 被動元件

+182%

記憶體漲幅最高，達 435%
顯示 VR200 對記憶體需求大幅提升

絕對金額增加最多前三名

1

記憶體

+\$1,627,661

2

GPU

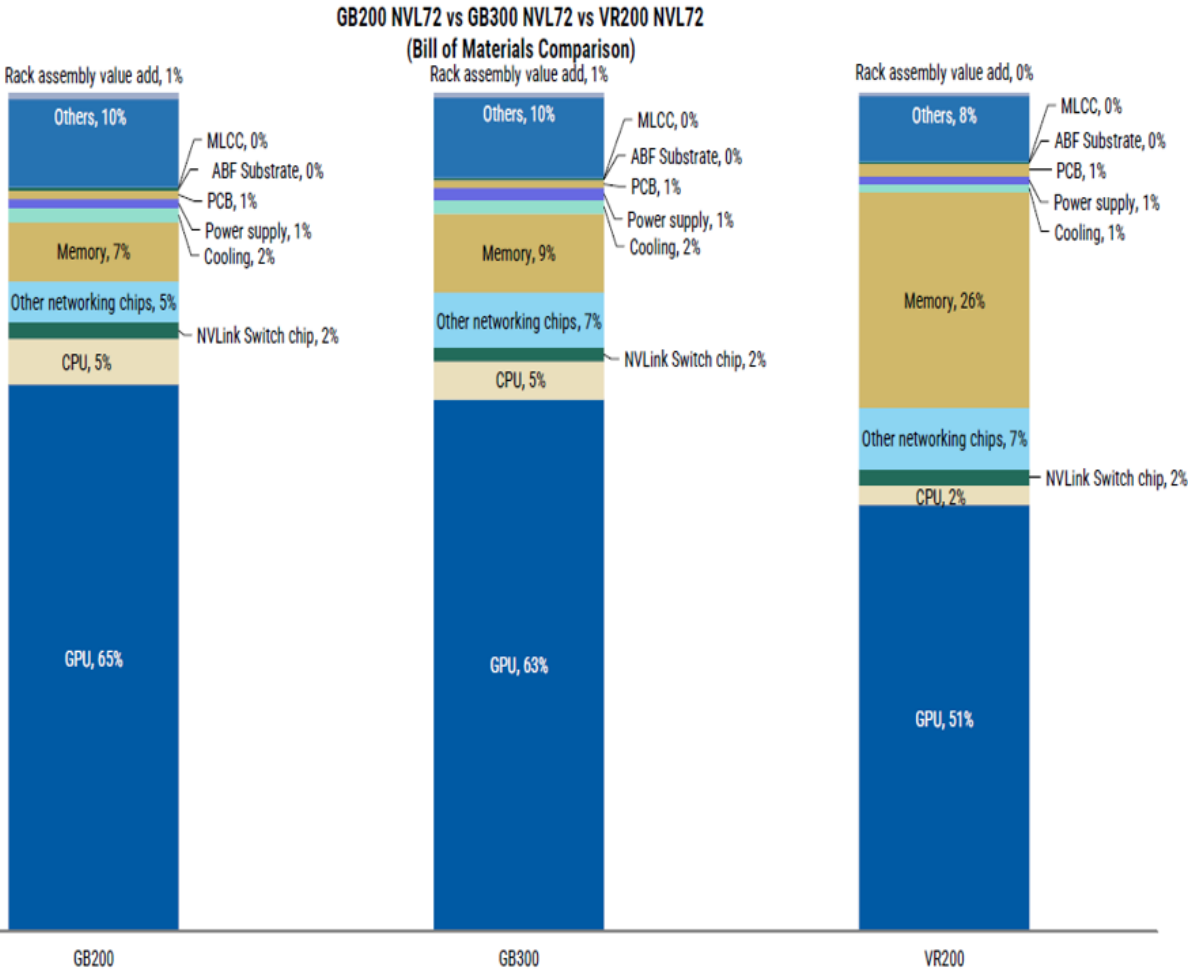
+\$1,440,000

3

其他網路晶片

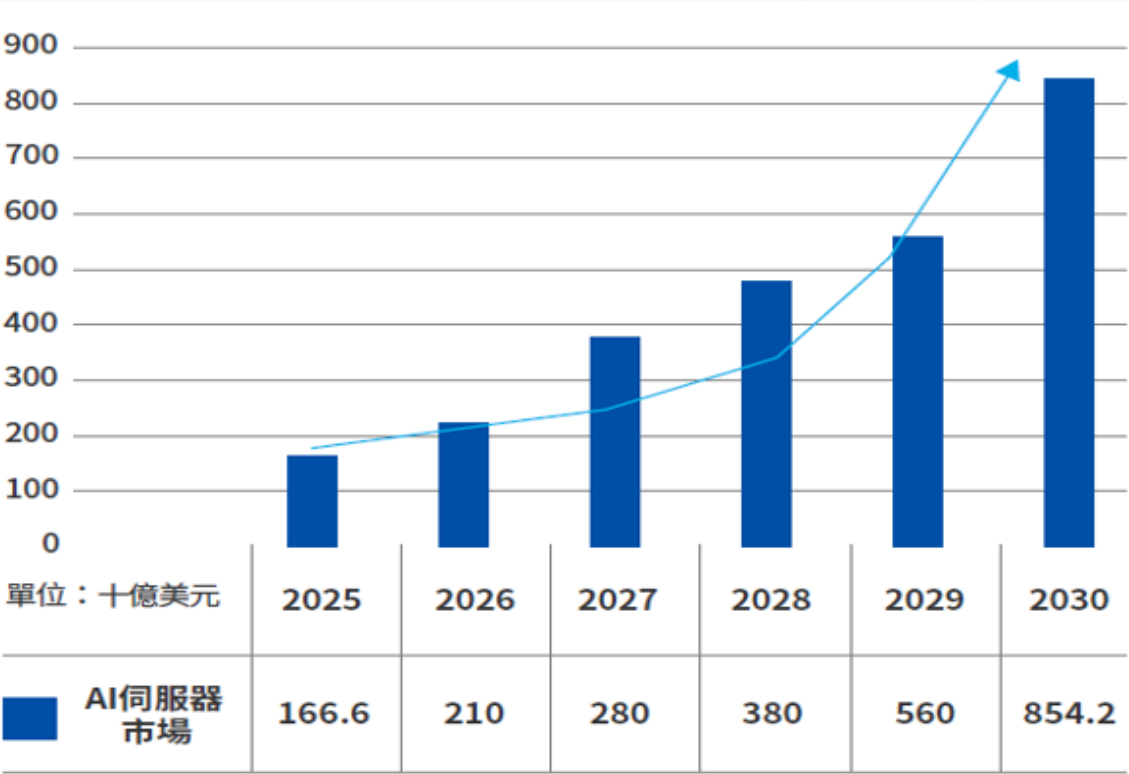
+\$315,000

記憶體增加金額最多，達 \$1.63M
為成本提升主因



資料來源：Morgan Stanley Research estimates。 註：金額單位為美元 (US\$)

2025-2030 AI伺服器及人形機器人市場預估



資料來源：Grand View Research



資料來源：DIGITIMES

AI 伺服器世代演進與核心MLCC(NP0)用量分析



時間與 GPU 世代	功耗(W)	高階MLCC 用料規格	單機使用數量(pcs)
2020 (A100)	1600-2200W	≥ 1206 NPO 10nF 630V	800 ~ 1000
2022 (H100)	3000-3200W	≥ 1210 NPO 22nF 1000V	1800 ~ 2000
2026(GB300)	5500-18000W	≥ 1210 NPO 33nF 1000V	3000 ~ 5000
2027	>30KW (800V HVDC)	≥ 1210 NPO 47nF	>3000 ~ 5000
(Rubin Ultra)		630V/33nF 1250V	

AI 伺服器次系統:100V DC高壓高溫MLCC(X7*/X8*)用量拆解

次系統應用	系統電壓溫度等級要求		MLCC 參考規格	單一機櫃/機種用量 (pcs)
PSU (電源)	48-54V	X7* (125°C)	≥ 1206 4.7uF 100V & ≥ 1210 10uF 100V	4000 ~ 7000
MB(主板)	48V	X7* (125°C)	≥ 1206 4.7uF 100V	1000 ~ 1500
Switch(交換機)	48V	X7* (125°C)	≥ 1206 4.7uF 100V	100 ~ 200
BBU (備援)	48V-75V	X7* (125°C)	≥ 1210 10uF 100V	3000 ~ 5000

針對2026/2027年GB300/Vera Rubin /Rubin Ultra 世代, 其電源與備援系統
運用大量高階大尺寸MLCC, 用量維持在30,000-50,000顆極高水位

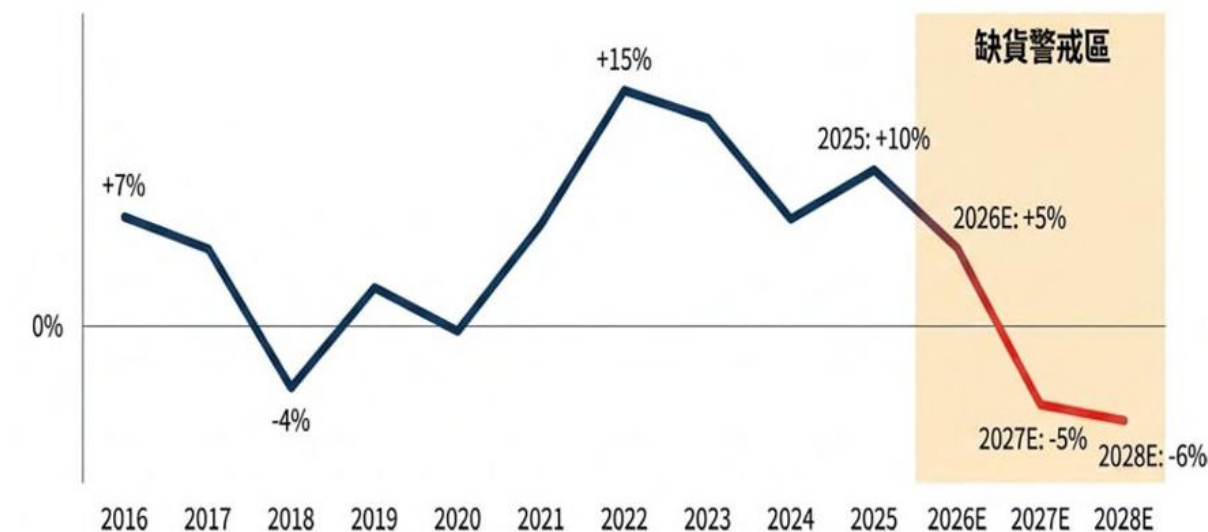
人形機器人驅動系統:高壓MLCC關節用量拆解



關節位置	系統電壓	規格	用量(pcs)
手臂、肩膀、小腿	48V	$\geq 1206, 4.7\mu\text{F}, 100\text{V}$	700 ~ 1300
手臂、肩膀、小腿	48V	$\geq 1210, 10\mu\text{F}, 100\text{V}$	300 ~ 600
中大型關節 (腰, 頸部)	72V	$\geq 1206, 2.2\mu\text{F}, 150\text{V}$	1500 ~ 1800
中大型關節 (腿部)	72V	$\geq 1206, 4.7\mu\text{F}, 120\text{V}$	200 ~ 400

實體機器人的大量關節馬達驅動 (AC/DC 轉換), 直接創造單台數千顆耐100V-150V 大尺寸的X7*高壓MLCC需求, 為被動元件開闢全新高毛利市場.

宏觀預測：2026-2028MLCC供需失衡模型



宏觀失衡確立。根據J.P. Morgan模型預測，未來三年產業將以24% CAGR擴張，供需缺口將在2026年快速收斂，並在2027-2028年陷入全面短缺，其緊縮程度預估將超越2017-2018週期。



- 1 2018年MLCC缺貨為一般消費型MLCC短缺,供應商眾多,屬於短暫型短缺,2026缺貨為高階小尺寸高容值及大尺寸高壓MLCC,供應商稀缺且需求量大預估至少短缺至2028年.
- 2 小尺寸高容主要供應商為日系Murata, Taiyo及韓系Semco.,高壓大尺寸台系主要為PDC, HEC

機會

- 近期美國4大CSP雲端服務大廠財報公布,7500億美元資本支出不變且有增加趨勢,確定後續需求樂觀,2026 Q4會有大量新導入規格之出貨效益產生,將增加2026 H2營業額及毛利.
- 市場大尺寸MLCC持續缺貨,訂單持續湧入與漲價帶來之效益於2026 H2起會明顯提升.
- 隨著2026 H2新產能陸續開出將有效掌握市場需求持續提升營業額及利潤.
- GB300及VR200 H2加速拉貨使得大尺寸高功率高可靠度之特殊設計MLCC需求大增.
- 展望2026,如前述AI Server、Data center、人形機器人、新能源車、低軌衛星、Medical、Aerospace為主要市場預估成長較高之領域,PDC大尺寸、高功率MLCC/ Chip-R應用機會增加.
- 高可靠度NPO MLCC 取代Film Cap及 X7R,X7T,X8* MLCC取代 Film Cap及鋁、鉭電解電容,致應用大增.

營業聚焦

■ MLCC、Chip-R –

- 繼AI Server ,EV,新能源設備,基地台應用發展成熟, 接著如人形機器人,自駕車,低軌衛星龐大市場需求將再次主導PDC大尺寸MLCC,及特殊電阻的新規格開發.
- 楊梅二廠主要生產高壓/低損耗高溫穩定型 MLCC,新廠預計於2027 Q2 完工並於2027 H2 開始量產.

■ 介電陶瓷粉末 –

- 六甲新廠主要是建置新一代自動化高效生產陶瓷粉末及開發次世代粉材產線,新廠預計於2027 Q2 完工並於2027 H2 開始量產. 此高規粉末廠可配合楊梅二廠之中高壓及大尺寸之高階MLCC導入高附加價值之市場及降低成本提升競爭力.
- 持續利用材料技術優勢開發特殊材料,如LEO low Dk 參雜材料、高頻微波通訊瓷粉、LTCC材料.

Thank you!

本資料均屬機密，僅供指定之收件人使用，未經寄件人許可不得揭露、複製或散佈本信件。

This message and any attachments are confidential and may be legally privileged. Any unauthorized review, use or distribution by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please immediately notify the sender, completely delete this documents, and destroy all copies. Your cooperation will be highly appreciated.

PASSIVE SYSTEM ALLIANCE

Prosperity Dielectrics Co., Ltd.